

用途別おすすめ品種一覧

| 分類 | 記載頁 | 商品名 | | 品番 | | |
|----------------|-----|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | 銅張積層板 | プリプレグ (RCC, 接着シートなど) | |
| 多層基板材料 | 14 | 超低伝送損失・高耐熱多層基板材料 | MEGTRON7 | R-5785(N) | R-5680(N) | |
| | 16 | 超低伝送損失・高耐熱多層基板材料 | MEGTRON6 | R-5775(N) | R-5670(N) | |
| | 18 | 超低伝送損失・高耐熱多層基板材料 | MEGTRON6 | R-5775 | R-5670 | |
| | 20 | 低伝送損失・高耐熱多層基板材料 | MEGTRON4 | R-5725 | R-5620 | |
| | 22 | 半導体パッケージ・モジュール基板向け超低損失基板材料 | MEGTRON GX | R-G545L, R-G545E | R-G540L, R-G540E | |
| | 24 | 高弾性・低熱膨張半導体パッケージ基板材料 | MEGTRON GX | R-G535S, R-G535E | - | |
| | 26 | 低応力・低熱膨張・極薄対応半導体パッケージ基板材料 | MEGTRON GX | R-G525T, R-G525F | R-G520T, R-G520F | |
| | 29 | 高弾性・低熱膨張・極薄対応半導体パッケージ基板材料 | MEGTRON GX | R-1515E | R-1410E | |
| | 31 | 高弾性・低熱膨張半導体パッケージ基板材料 | MEGTRON GX | R-1515W | R-1410W | |
| | 33 | 低熱膨張半導体パッケージ基板材料 | MEGTRON GX | R-1515A | R-1410A | |
| | 35 | 高耐熱ハロゲンフリー多層基板材料 | | R-1566S | R-1551S | |
| | 38 | 高耐熱多層基板材料<High-Tgタイプ> | HIPER | R-1755S | R-1650S | |
| | 40 | 高耐熱・低熱膨張多層基板材料<High-Tgタイプ> | HIPER D | R-1755D | R-1650D | |
| | 43 | 高耐熱・低熱膨張多層基板材料 | HIPER E | R-1755E | R-1650E | |
| | 46 | ハロゲンフリー多層基板材料 | | R-1566 | R-1551 | |
| | 49 | 多層基板材料 | | R-1766 | R-1661 | |
| 両面基板材料 | 52 | 内層回路入り多層基板材料(シールド板) | プレマルチ | C-1810 | - | |
| | 58 | 高信頼性ガラスコンポジット基板材料 | | R-1785 | - | |
| | 61 | 高熱伝導性ガラスコンポジット基板材料 | ecool | R-1787 | - | |
| | 64 | ガラスコンポジット基板材料 | | R-1786 | - | |
| | 67 | ガラスエポキシ基板材料 | | R-1705 | - | |
| | - | 紙フェノール基板材料 | | R-8705 | - | |
| 片面基板材料 | - | 低吸湿・高耐熱性ペーストスルーホール用紙フェノール基板材料 | | R-8705(EF) | - | |
| | 73 | 高耐熱紙フェノール基板材料 | | R-8700(EF) | - | |
| | 77 | 高耐トラッキング性紙フェノール基板材料 | | R-8700(SB) | - | |
| | 81 | 紙フェノール基板材料 | | R-8700 | - | |
| フレキシブル 基板材料 | 85 | ハロゲンフリー紙フェノール基板材料 | | R-8500 | - | |
| | 90 | フレキシブル基板材料 LCP(液晶ポリマー) | FELIOS LCP | R-F705S | - | |
| | 92 | フレキシブル基板材料 樹脂付銅箔 | FELIOS FRCC | - | R-FR10 | |
| | 94 | フレキシブル基板材料 | FELIOS | R-F775 | - | |

| | ハロゲンフリー | 主 要 用 途 ・ ニ ー ズ | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | アンテナ・高周波部品 | ICTインフラ機器 | 計測機器・半導体試験装置 | 車載機器 | 半導体パッケージ基板 | スマートフォン・フィーチャーフォン | PC・周辺機器 | ゲーム機・アミューズメント | LED | アプライアンス | 産業機器 |
| | | ・高速伝送 ・高周波特性 ・低伝送損失 (低Dk低Df) | ・高速伝送 ・省エネ ・低伝送損失 (低Dk低Df) ・高耐熱性 ・多層成型性 | ・高周波特性 ・高耐熱性 ・高信頼性 | ・長期信頼性 ・高耐熱性 ・大電流 ・大電圧化 ・実装信頼性 | ・小型 薄型化 ・低反り ・高信頼性 ・高耐熱性 ・高剛性 | ・高機能化 ・基板の超薄型化 ・基板の極小化 ・L/S狭ピッチ化 | ・小型 薄型化 ・軽量化 ・低Dk/低Df (USB 3.1) | ・小型 薄型化 ・軽量化 ・高性能化 ・鉛フリー はんだ対応 | ・高放熱性 ・高耐熱性 ・高信頼性 | ・小型 薄型化 ・軽量化 ・耐トラッキング性 ・高信頼性 | ・高耐熱性 ・耐トラッキング性 ・厚銅箔 |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | ● | ● | | | | | | | | | |
| | ● | | | | | ● | | | | | | |
| | ● | | | | | ● | | | | | | |
| | ● | | | | | ● | | | | | | |
| | ● | | | | | ● | | | | | | |
| | ● | | | | | ● | | | | | | |
| | ● | | | | | ● | | | | | | |
| | ● | | | | ● | | | | | | | |
| | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | | | | ● | | | | | | | |
| | | | | | ● | | | | | | ● | |
| | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | | ● | | | ● | | | ● | ● | | ● | ● |
| | | | | | ● | | | | ● | | ● | ● |
| | | | | | ● | | | | ● | | ● | ● |
| | | | | | ● | | | | ● | | ● | ● |
| | | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | |
| | | | | | | | | | ● | | ● | |
| | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | |
| | ● | | | | | | | | ● | | ● | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | ● | | | | | | ● | | | | ● | |
| | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | |